



Doppelseitig und Multilayer

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von starren Platinen sowie der neuesten Anlagentechnologie können wir auch komplexeste Ausführungen von doppelseitigen und Multilayer-Platinen realisieren. Nicht ohne Grund zählen zahlreiche Unternehmen aus der ganzen Welt zu unserem Kundenstamm. Insbesondere wenn es sich um Anwendungsgebiete mit hohem technologischen Anspruch und höchsten Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit handelt.

Technologische Highlights

- ▶ Alle Arten von Basismaterial speziell abgestimmt auf die jeweiligen Einsatzbereiche:
 - FR4
 - Alle Arten von Hoch-TG Materialien (gefüllt und ungefüllt)
 - Material mit hoher Kriechstromfestigkeit
 - Keramisch verfüllte Materialien
 - HF-Materialien Teflon (PTFE) und Non PTFE (z.B. RO 4350)
 - Polyimide
 - LCP- Materialien
- ▶ Z-Achsen und X / Y Achsenoptimierte Layup-Konstruktionen
- ▶ Übergrößen bis 1200 mm
- ▶ Temperaturwechselbeständigkeit 1000 Zyklen von -65°C bis $+150^{\circ}\text{C}$
- ▶ Gefüllte und übermetallisierte Vias (Thermal Vias)
- ▶ Exakte Leiterbahnenbreiten mit hoher Signalintegrität / Impedanzprüfung mit Protokoll
- ▶ Einpresstechnik
- ▶ Erhöhung der Durchschlagsfestigkeit und mechanischer Schutz durch auf den Außenlagen aufflaminierte Deckfolien oder Prepregs
- ▶ E – Test bis 5000 V
- ▶ 100 % Rückverfolgbarkeit der Fertigung

Technische Ausführungen	Werte
Materialdicke	Min 50 / 5 μm
Line / Space (25 μm Kupfer)	60 / 60 μm
Microvias / Pad Durchmesser	75 μm / 250 μm
Aspect ratio	1 : 12
Leiterbahntoleranz	20 %
IPC Klassen	2 oder 3